中国人工智能芯片行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2023-2030年)

报告大纲

观研报告网 www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国人工智能芯片行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址: http://www.chinabaogao.com/baogao/202307/642957.html

报告价格: 电子版: 8200元 纸介版: 8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人:客服

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

人工智能芯片简称AI芯片,是指应用在人工智能算法加速,主要实现大规模并行计算的芯片。而在更广泛的概念下,任何应用在人工智能领域的芯片都可被称为人工智能芯片。根据应用场景,AI芯片可分为云端芯片、边缘端芯片和终端芯片;根据功能可分为训练芯片和推断芯片。

芯片是信息化时代、数字化时代的基石。近年来宏观政策的大力支持和人工智能的普遍应用促进了AI芯片市场的高速扩张。数据显示,2017-2021年我国我国AI芯片市场规模由53亿元增至2021年436.8亿元,年均复合增长率为69.4%。预计2022年我国AI芯片市场规模将增至850.2亿元。

数据来源:观研天下整理

得益于市场发展向好,近年我国AI芯片企业注册量也在快速增长。数据显示,2017-2021年 我国AI芯片企业注册量由1110家迅速增长至13492家,年均复合增长率达86.7%。2022年1-5月,我国AI芯片企业注册量达6783家,已超过2020年新增企业数量,行业竞争进一步加剧

数据来源:企查查;观研天下整理

虽然目前我国作为全球最大的半导体消费市场,但芯片自给率不足,严重依赖进口。为发展国产芯片,实现进口替代,近年来政府出台了一系列政策支持国产芯片行业发展。2020年8月,国务院发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出将从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等8个方面对集成电路和软件产业进行扶持,以加快集成电路和软件产业发展。AI芯片的发展将受益于芯片国产化的政策支持和庞大的国内市场需求。

目前AI芯片设计更多的是从技术需求的角度出发,如芯片架构的选择、芯片性能指标提升等。随着AI芯片领域的竞争越来越激烈,各芯片企业除了在技术层面有所突破,还需加大应用场景的布局,以抢占更多的发展机遇。为了适应碎片化的应用市场,未来的芯片设计需要以客户终端需求为导向,从需求量、商业落地模式、市场壁垒等各个方面综合分析落地的可行性,借助场景落地实现AI芯片的规模发展。

总体来看,目前我国AI芯片领域呈现国外厂商主导市场,国内企业跟随及挖掘细分市场需求的竞争业态。国内市场企业主要有海思半导体、联发科技、寒武纪、中星微电子、平头哥、四维图新、昆仑芯、北京君正、芯原微电子、瑞芯微电子等。

我国AI芯片领域主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

海思半导体

研发优势:海思在中国、新加坡、韩国、日本、欧洲等地设有12个办事处和研发中心

市场优势:公司产品和服务遍布全球100多个国家和地区。

品牌优势:2020年8月4日,海思名列2020中国新型创新企业50强第1位。2021年12月25日

,位列《中国半导体企业 100 强》,排名第1位。

联发科技

市场地位优势:公司是全球第四大无晶圆厂半导体公司,在移动终端、智能家居应用、无线连接技术及物联网产品等市场位居领先地位。

品牌优势:2022年12月,公司位列《2022胡润世界500强》第495位。2022年5月,公司入选福布斯2022全球企业2000强榜单,排名第453位。2023年1月,公司位列《2022年 · 胡润中国500强》第22位。

销售优势:公司一年约有 20亿台内建MediaTek芯片的终端产品在全球各地上市。

寒武纪

技术优势:公司掌握的智能处理器指令集、智能处理器微架构、智能芯片编程语言、智能芯片数学库等核心技术,具有壁垒高、研发难、应用广等特点,对集成电路行业与人工智能产业具有重要的技术价值、经济价值和生态价值。

专利优势:。截至2022年6月30日,公司累计申请的专利为2,607项,按照专利地域可分为:境内专利申请1,697项,境外专利申请646项,PCT专利申请264项;按照专利类型可分为:发明专利申请2,537项,实用新型专利申请34项,外观设计专利申请36项。公司累计已获授权的专利为698项,按照专利地域可分为:境内专利514项,境外专利184项;按照类型可分为:发明专利633项,实用新型专利32项,外观设计专利33项。此外,公司拥有软件著作权61项;集成电路布图设计6项。

人才优势:公司在技术研发、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队,核心骨干均有多年从业经验。公司核心研发人员多毕业于著名高校或科研院所,拥有计算机、微电子等相关专业的学历背景,多名骨干成员拥有知名半导体公司多年的工作经历。公司员工中有80.04%为研发人员,77.05%的研发人员拥有硕士及以上学位,研发队伍结构合理、技能全面,有力支撑了公司的技术创新和产品研发。

产品体系优势:目前,公司已推出的产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片及其加速卡、训练整机、处理器IP及软件,可满足云、边、端不同规模的人工智能计算需求。

中星微电子

技术优势: 中星微电子坚持自主创新,先后突破十五大核心技术,申请了4000多项国际和国内专利,并两次荣膺年度国家科技进步一等奖。

产品优势:公司自主设计的嵌入式神经网络处理器(NPU)采用了"数据驱动并行计算"架构 ,专门针对深度学习算法进行了优化,具备高性能、低功耗、高集成度、小尺寸等特点,特别适合物联网前端智能的需求。

客户优势:公司产品销售已经覆盖了欧、美、日、韩等16个国家和地区,客户囊括了索尼、三星、惠普、飞利浦、富士通、罗技、华为、联想等大批国内外知名企业。

平头哥

设计链路全覆盖优势:平头哥拥有端云一体全栈产品系列,涵盖数据中心芯片、loT芯片、 处理器IP授权等,实现芯片端到端设计链路全覆盖。

背景优势:公司是阿里巴巴旗下半导体公司。

品牌优势:2020年8月4日,平头哥半导体名列2020中国新型创新企业50强第11位。

四维图新

PB数据优势:公司拥有PB级多源数据以及TB级日增量,包括道路、POI、轨迹行为、天气、 交通、卫星影像、CORS基站、充电桩、车辆传感器回传数据、城市传感器回传数据等。

人才优势:公司凭借公司在行业的影响力,先后引进国内外高科技企业高端人才,加强和国内"985"、"211"高校的联系,并与哈尔滨工业大学、华中科技大学等高校建立校企合作关系。同时,公司依托在美国硅谷、荷兰、新加坡、日本设立子公司,不断丰富壮大全球优秀人才队伍,为公司进一步吸纳全球最前沿科技的专业人才、占领人才高地奠定了坚实基础。

客户优势:公司汽车客户主要包括欧美品牌、日系品牌、国内自主品牌、造车新势力等车企,与诸如戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃、丰田、雷克萨斯、长城及国内知名新能源车厂等众多主流车企形成长期稳定积极的合作关系。

昆仑芯

先发优势:公司在国内最早布局AI加速领域,深耕10余年,是一家在体系结构、芯片实现、 软件系统和场景应用均有深厚积累的AI芯片企业。

产品优势:昆仑芯科技已实现两代通用AI芯片产品的量产及落地应用,两代产品先后斩获20 20、2021年中国芯"优秀技术创新产品"奖。

产量优势:昆仑芯1代AI芯片于2020年量产,在百度搜索引擎、小度等业务中部署数万片, 是国内唯一一款经历过互联网大规模核心算法考验的云端AI芯片。

品牌优势:2021年,昆仑芯2代荣获2021年第十六届中国芯"优秀技术创新产品"奖。2023年4月18日,以140亿人民币的企业估值入选《2023·胡润全球独角兽榜》,排名504。

北京君正

技术优势:经过十几年的持续投入,公司在以下领域逐步形成了自主关键技术:(1)嵌入式CPU技术。公司创业团队多年来从事嵌入式CPU技术的研发,在高性能、低功耗等关键指标上获得了突破。公司基于32位MIPS指令集架构设计了XBurst系列CPU内核,该内核采用了公司创新的微体系结构,其主频、功耗和面积水平在同等工艺下均领先于业界现有的同类32位RISC微处理器内核。从2014年开始,指令集开源的RISC-V架构获得了业界的广泛支持和快速发展,公司积极拥抱这一趋势,适时展开了基于RISC-V架构的CPU核的研发。(2)视频编解码技术。视频内容是最核心的多媒体内容,公司自主研发的视频编解码器,能够支持大多数国际上主流的视频格式,包括多种主流视频格式的解码和H264格式、H265格式等码流的编码,公司的

视频编解码器对编码关键路径采用算法优化和硬件优化结合的方式提高性能,通过精细设计的开关控制等降低动态功耗,使整体的性能、面积、功耗达到业界先进水平,有利地支持了公司在智能视频领域的拓展。

产品优势:公司产品普遍具有高性能、低功耗特质。这些特质来自于公司核心技术的特性,并且在业内获得了普遍的认可。

性价比优势:由于核心技术自主研发,公司在芯片设计、生产和销售等阶段的相关技术授权费用大为降低,并可在芯片设计时根据产品的具体需要对相关模块进行裁剪,避免了设计上的冗余。综合这几个方面,公司产品具有更高的性价比。

资质优势:基于业务发展方面的需要,公司部分子公司通过了ISO9001质量管理体系认证,符合ISO14001环境保护标准。此外,公司相关管理体系还获得了ISO26262的质量体系认证(ASIL-D等级),能够开发具备各ASIL等级的芯片。

芯原微电子

一站式服务优势:芯原是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片 定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱 乐系统处理器、视频监控、物联网连接、智慧可穿戴、高端应用处理器、视频转码加速、智能像素处理等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP、图像信号处理器IP和显示处理器IP六类处理器IP、1,400多个数模混合IP和射频IP。

产品种类优势:公司拥有用于集成电路设计的GPUIP、NPUIP、VPUIP、DSPIP、ISPIP、DisplayProcessorIP六类处理器IP、1,400多个数模混合IP和射频IP。

市场地位优势:2021年,芯原半导体IP授权业务市场占有率位列中国大陆第一,全球第七;IP种类在前七中排名前二;2020年和2021年,芯原的知识产权授权使用费收入均排名全球第四。工艺设计优势:公司拥有从先进的5nmFinFET到传统的250nmCMOS工艺节点芯片的设计

能力。

瑞芯微电子

技术创新优势:近年来,公司重点发展AloT相关产品及技术。围绕AloT应用需求,重点研发了人工智能处理、图像及视觉处理、智能语音、光电一体化等核心技术,同时改进优化原有的视频编解码、多屏幕显示等技术,已形成完善的高精度感知、认知、交互的整体解决方案。专利优势:截至2022年6月30日,公司申请了1,009项专利(其中包括956项发明专利,38项实用新型专利,15项外观设计专利)、42项布图设计权以及235项软件著作权,已获得授权594项专利(其中包括572项发明专利,8项实用新型专利,14项外观设计专利)、27项布图设计权以及232项软件著作权。

产品类型优势:公司芯片产品品类丰富,智能应用处理器产品可契合不同终端产品的市场定位及成本要求。

资料来源:观研天下整理(WW)

注:上述信息仅作参考,具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国人工智能芯片行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国人工智能芯片行业发展概述

第一节人工智能芯片行业发展情况概述

- 一、人工智能芯片行业相关定义
- 二、人工智能芯片特点分析
- 三、人工智能芯片行业基本情况介绍
- 四、人工智能芯片行业经营模式
- 1、生产模式
- 2、采购模式
- 3、销售/服务模式
- 五、人工智能芯片行业需求主体分析
- 第二节中国人工智能芯片行业生命周期分析
- 一、人工智能芯片行业生命周期理论概述
- 二、人工智能芯片行业所属的生命周期分析
- 第三节人工智能芯片行业经济指标分析
- 一、人工智能芯片行业的赢利性分析
- 二、人工智能芯片行业的经济周期分析
- 三、人工智能芯片行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球人工智能芯片行业市场发展现状分析

第一节全球人工智能芯片行业发展历程回顾

第二节全球人工智能芯片行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲人工智能芯片行业地区市场分析

- 一、亚洲人工智能芯片行业市场现状分析
- 二、亚洲人工智能芯片行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲人工智能芯片行业市场前景分析

第四节北美人工智能芯片行业地区市场分析

- 一、北美人工智能芯片行业市场现状分析
- 二、北美人工智能芯片行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美人工智能芯片行业市场前景分析

第五节欧洲人工智能芯片行业地区市场分析

- 一、欧洲人工智能芯片行业市场现状分析
- 二、欧洲人工智能芯片行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲人工智能芯片行业市场前景分析

第六节 2023-2030年世界人工智能芯片行业分布走势预测 第七节 2023-2030年全球人工智能芯片行业市场规模预测

第三章 中国人工智能芯片行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对人工智能芯片行业的影响分析

第三节中国人工智能芯片行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规
- 三、主要行业标准

第四节政策环境对人工智能芯片行业的影响分析 第五节中国人工智能芯片行业产业社会环境分析

第四章 中国人工智能芯片行业运行情况

第一节中国人工智能芯片行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

第二节中国人工智能芯片行业市场规模分析

一、影响中国人工智能芯片行业市场规模的因素

- 二、中国人工智能芯片行业市场规模
- 三、中国人工智能芯片行业市场规模解析

第三节中国人工智能芯片行业供应情况分析

- 一、中国人工智能芯片行业供应规模
- 二、中国人工智能芯片行业供应特点

第四节中国人工智能芯片行业需求情况分析

- 一、中国人工智能芯片行业需求规模
- 二、中国人工智能芯片行业需求特点

第五节中国人工智能芯片行业供需平衡分析

第五章 中国人工智能芯片行业产业链和细分市场分析

第一节中国人工智能芯片行业产业链综述

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、产业链运行机制
- 三、人工智能芯片行业产业链图解

第二节中国人工智能芯片行业产业链环节分析

- 一、上游产业发展现状
- 二、上游产业对人工智能芯片行业的影响分析
- 三、下游产业发展现状
- 四、下游产业对人工智能芯片行业的影响分析

第三节我国人工智能芯片行业细分市场分析

- 一、细分市场一
- 二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国人工智能芯片行业市场竞争分析

第一节中国人工智能芯片行业竞争现状分析

- 一、中国人工智能芯片行业竞争格局分析
- 二、中国人工智能芯片行业主要品牌分析

第二节中国人工智能芯片行业集中度分析

- 一、中国人工智能芯片行业市场集中度影响因素分析
- 二、中国人丁智能芯片行业市场集中度分析

第三节中国人工智能芯片行业竞争特征分析

- 一、企业区域分布特征
- 二、企业规模分布特征
- 三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国人工智能芯片行业模型分析

第一节中国人工智能芯片行业竞争结构分析(波特五力模型)

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

第二节中国人工智能芯片行业SWOT分析

- 一、SOWT模型概述
- 二、行业优势分析
- 三、行业劣势
- 四、行业机会
- 五、行业威胁
- 六、中国人工智能芯片行业SWOT分析结论

第三节中国人工智能芯片行业竞争环境分析(PEST)

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国人工智能芯片行业需求特点与动态分析

第一节中国人工智能芯片行业市场动态情况

第二节中国人工智能芯片行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节人工智能芯片行业成本结构分析

第四节人工智能芯片行业价格影响因素分析

一、供需因素

- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节中国人工智能芯片行业价格现状分析

第六节中国人工智能芯片行业平均价格走势预测

- 一、中国人工智能芯片行业平均价格趋势分析
- 二、中国人工智能芯片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国人工智能芯片行业所属行业运行数据监测

第一节中国人工智能芯片行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节中国人工智能芯片行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节中国人工智能芯片行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国人工智能芯片行业区域市场现状分析

第一节中国人工智能芯片行业区域市场规模分析

- 一、影响人工智能芯片行业区域市场分布的因素
- 二、中国人工智能芯片行业区域市场分布

第二节中国华东地区人工智能芯片行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区人工智能芯片行业市场分析
- (1)华东地区人工智能芯片行业市场规模
- (2)华南地区人工智能芯片行业市场现状
- (3)华东地区人工智能芯片行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区人工智能芯片行业市场分析
- (1)华中地区人工智能芯片行业市场规模
- (2)华中地区人工智能芯片行业市场现状
- (3)华中地区人工智能芯片行业市场规模预测 第四节华南地区市场分析
- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区人工智能芯片行业市场分析
- (1)华南地区人工智能芯片行业市场规模
- (2)华南地区人工智能芯片行业市场现状
- (3)华南地区人工智能芯片行业市场规模预测 第五节华北地区人工智能芯片行业市场分析
- 一、华北地区概述
- 二、华北地区经济环境分析
- 三、华北地区人工智能芯片行业市场分析
- (1) 华北地区人工智能芯片行业市场规模
- (2) 华北地区人工智能芯片行业市场现状
- (3)华北地区人工智能芯片行业市场规模预测 第六节东北地区市场分析
- 一、东北地区概述
- 二、东北地区经济环境分析
- 三、东北地区人工智能芯片行业市场分析
- (1) 东北地区人工智能芯片行业市场规模
- (2) 东北地区人工智能芯片行业市场现状
- (3)东北地区人工智能芯片行业市场规模预测 第七节西南地区市场分析
- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区人工智能芯片行业市场分析
- (1)西南地区人工智能芯片行业市场规模
- (2) 西南地区人工智能芯片行业市场现状
- (3)西南地区人工智能芯片行业市场规模预测 第八节西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区人工智能芯片行业市场分析
- (1) 西北地区人工智能芯片行业市场规模
- (2) 西北地区人工智能芯片行业市场现状
- (3) 西北地区人工智能芯片行业市场规模预测

第十一章 人工智能芯片行业企业分析(随数据更新有调整)

第一节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析
- 四、公司优势分析

第二节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第六节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第七节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第八节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第九节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十二章 2023-2030年中国人工智能芯片行业发展前景分析与预测

第一节中国人工智能芯片行业未来发展前景分析

- 一、人工智能芯片行业国内投资环境分析
- 二、中国人工智能芯片行业市场机会分析
- 三、中国人工智能芯片行业投资增速预测

第二节中国人工智能芯片行业未来发展趋势预测

第三节中国人工智能芯片行业规模发展预测

- 一、中国人工智能芯片行业市场规模预测
- 二、中国人工智能芯片行业市场规模增速预测
- 三、中国人工智能芯片行业产值规模预测
- 四、中国人工智能芯片行业产值增速预测
- 五、中国人工智能芯片行业供需情况预测
- 第四节中国人工智能芯片行业盈利走势预测

第十三章 2023-2030年中国人工智能芯片行业进入壁垒与投资风险分析

- 第一节中国人工智能芯片行业进入壁垒分析
- 一、人工智能芯片行业资金壁垒分析
- 二、人工智能芯片行业技术壁垒分析
- 三、人工智能芯片行业人才壁垒分析
- 四、人工智能芯片行业品牌壁垒分析
- 五、人工智能芯片行业其他壁垒分析
- 第二节人工智能芯片行业风险分析
- 一、人工智能芯片行业宏观环境风险
- 二、人工智能芯片行业技术风险
- 三、人工智能芯片行业竞争风险
- 四、人工智能芯片行业其他风险
- 第三节中国人工智能芯片行业存在的问题
- 第四节中国人工智能芯片行业解决问题的策略分析

第十四章 2023-2030年中国人工智能芯片行业研究结论及投资建议

- 第一节观研天下中国人工智能芯片行业研究综述
- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估
- 第二节中国人工智能芯片行业进入策略分析
- 一、行业目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

第三节 人工智能芯片行业营销策略分析

- 一、人工智能芯片行业产品策略
- 二、人工智能芯片行业定价策略
- 三、人工智能芯片行业渠道策略

四、人工智能芯片行业促销策略 第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问: http://www.chinabaogao.com/baogao/202307/642957.html